



## Automatischer Großflächen Bond Tester 8600C

### Test System

**Testköpfe** Pullköpfe – 100 cN, 1000 cN, 5000 cN  
Shearköpfe – 500 cN, 5000 cN

### Maschinen Basis

**Verfahrwege** X=700mm, Y=480mm, Z=100mm  
Schrittauflösung 1 µm, Reproduzierbarkeit 5 µm

**Geschwindigkeit** Alle Achsen programmierbar von 0,2 bis 16 mm/s  
Testgeschwindigkeit von 0,2 bis 5 mm/s

### Messköpfe

**Genauigkeit** 0,25 % vom Maximalwert  
**Kalibrierung** Im Messkopf gespeichert, Temperatur-  
kompensierte Wägezelle  
Optionale Kalibrierung beim Kunden  
(spezifische Werkzeuge)

### Steuerung

**Computer** Dual Core PC, Ethernet, USB 2.0/3.0  
GigE-CCD-Farbkamera,  
voll netzwerkfähig im TCP/IP-Server

**Monitor** TFT-Flachbildschirm 22"

**Drucker** alle Windows-kompatiblen Drucker können  
installiert werden

### 8600C:

Der automatische Bondtester 8600C ergänzt die Die- und Drahtbonder der F&S Bondtec Semiconductor GmbH.

Durch die PC-gesteuerte Achse können aus einem hinterlegten Programm beliebig viele Bonds automatisch geprüft werden (z.B. für Batterie-, Solar- Anwendung, etc.).

Die Ergebnisse können analysiert und sofort ausgegeben oder in eine Reihe von Datenbankformaten für die spätere Analyse exportiert werden.

Weitere leistungsstarke Funktionen ermöglichen Messungen wie Kraft-Zeit-Kurven und liefern zusätzliche Daten über die Qualität der getesteten Verbindung.

Wechselbare Messkassetten sorgen für eine schnelle Umrüstung auf unterschiedliche Kraftbereiche

## Zusatzfunktionen

- Programmierung** Automatische Wiederholungsmessungen an Hybriden oder COB mit programmierbarer Kopfbewegung und Pattern Recognition Unit (PRU)
- Auswertung** Statistiken wie Mittelwert, Standardabweichung, Trend, cpk etc. Basierend auf SQL-Datenbank
- Export Format** SQL, CSV, HTML
- Sonstiges** Bedienerprofile, verschiedene Passwortebenen, optionale Barcodeleser zur Produktidentifikation; Rückführung der Messwerte an Die- und Drahtbonder zur Parameteroptimierung (optional)

## **Allgemein**

- Mikroskop** Stereoskop Olympus, andere Mikroskope optional
- Abmessungen** ca. Höhe 200 cm, Breite 130 cm, Tiefe 100 cm, ca. 700kg
- Versorgung** 230 VAC,
- Anschlüsse** Luft 6 bar; Vakuum 0,7 bar

### **F&S Bondtec Semiconductor GmbH**

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: [info@fsbondtec.at](mailto:info@fsbondtec.at)

Web: [www.fsbondtec.at](http://www.fsbondtec.at)

